

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LIMITED

华虹宏力半导体有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：01347)

新闻稿

二零二六年第二季度业绩公布

所有货币以美元列帐，除非特别指明。

本合并财务报告系依香港财务报告准则编制。

中国香港 — 2026 年 8 月 13 日 — 全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂华虹宏力半导体有限公司（香港联交所股票代码：01347；上交所科创板证券代码：688347）（“本公司”）于今日公布截至二零二六年六月三十日止三个月的综合经营业绩。

二零二六年第二季度主要财务指标（未经审核）

- 销售收入创历史新高，达 7.175 亿美元，同比增长 26.8%，环比增长 8.6%。
- 毛利率 16.5%，同比上升 5.6 个百分点，环比上升 3.5 个百分点。
- 母公司拥有人应占利润 3,860 万美元，同比上升 385.9%，环比上升 84.6%。

二零二六年第三季度指引

- 我们预计销售收入约在 7.7 亿美元至 7.8 亿美元之间。
- 我们预计毛利率约在 16% 至 18% 之间。

总裁致辞

华虹宏力董事会主席兼总裁白鹏博士对公司二零二六年第二季度业绩评论道：

“华虹宏力二零二六年第二季度经营表现持续改善，盈利能力进一步提升。销售收入创历史新高，达 7.175 亿美元，同比增长 26.8%；毛利率为 16.5%，同比上升 5.6 个百分点。两项指标均优于指引，并均实现环比提升。母公司拥有人应占利润 3,860 万美元，同比及环比亦大幅增长。二季度，公司保持高产能利用率，各工艺技术平台均实现增长，其中独立式和嵌入式非易失性存储器产品表现尤为突出。产品量价齐升，促进公司经营业绩改善。”

白总继续表示：“自年初以来，人工智能持续驱动全球半导体行业需求增长，相关需求最先在存储器芯片产品中体现，并逐步扩展至与人工智能应用相关的逻辑和模拟芯片产品。作为服务于广泛终端市场的特色工艺晶圆代工企业，公司业务已明显受益于人工智能浪潮带来的积极影响。同时，我们也看到，不同终端细分市场的需求强度和持续性仍存在分化。面对快速演变的行业格局，公司坚持稳步扩充产能、持续升级特色工艺技术并不断优化产能配置和产品组合的战略，把握新的增长机遇，推动经营业绩持续改善。华虹宏力近日已获得中国证券监督管理委员会对华力微收购事项的注册批复。资产整合后，将进一步强化公司技术组合，提升运营规模效应并改善盈利能力，为公司未来发展注入新的动力。”

电话会议公告

日期 2026 年 8 月 13 日，星期四

时间： 17:00 香港/上海时间

05:00 美国东部时间

发言人： 白鹏，董事会主席兼总裁
王鼎，执行副总裁兼首席财务官

广播： 会议将在 https://www.huahonggrace.com/s/ir_calendar.php 或
<https://edge.media-server.com/mmc/p/v5ngm38a> 作线上直播
(请提前注册登记)

电话直拨： 请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN
(个人身份识别码)。

<https://register-conf.media-server.com/register/BI5899f0c2c6ab4ae29ebd89d5682ac3e6>

重要提示：在会议开始前，您需要使用确认邮件中提供的 PIN (个人身份识别码) 才能进入会议。请在注册后，注意查收并保存确认邮件。出于安全原因，请不要与任何人共享您的 PIN (个人身份识别码)。

网上回放： 直播约 2 小时后，您于 12 个月内在以下网页重复收听会议。
https://www.huahonggrace.com/s/ir_calendar.php

关于华虹宏力半导体

华虹宏力半导体有限公司 (A 股简称: 华虹宏力, 688347; 港股简称: 华虹宏力, 01347) (“本公司”) 是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业, 秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先进“特色 IC + Power Discrete”的发展战略, 为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等特色工艺技术的持续创新, 有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用, 其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员, 而华虹集团是中国拥有“8 英寸 + 12 英寸”先进集成电路制造主流工艺技术的产业集团。

本公司在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂, 另在无锡高新技术产业开发区内建有两座全球领先的 12 英寸特色工艺晶圆厂, 其中之一是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。

如欲取得更多公司相关资料, 请浏览: www.huahonggrace.com。

经营业绩概要
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二六年 第二季度 (未经审核)	二零二五年 第二季度 (未经审核)	二零二六年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
销售收入	717,537	566,065	660,925	26.8 %	8.6 %
毛利	118,404	61,611	86,059	92.2 %	37.6 %
毛利率	16.5 %	10.9 %	13.0 %	5.6	3.5
经营开支	(109,083)	(97,917)	(105,613)	11.4 %	3.3 %
其他收入/(损失)净额	2,189	10,602	(2,448)	(79.4)%	(189.4)%
税前溢利/(损失)	11,510	(25,704)	(22,002)	(144.8)%	(152.3)%
所得税(开支)/抵免	(7,632)	(7,097)	4,735	7.5 %	(261.2)%
期内溢利/(损失)	3,878	(32,801)	(17,267)	(111.8)%	(122.5)%
净利润率	0.5 %	(5.8)%	(2.6)%	6.3	3.1
以下各方应占:					
母公司拥有人	38,639	7,952	20,929	385.9 %	84.6 %
非控股权益	(34,761)	(40,753)	(38,196)	(14.7)%	(9.0)%
持有人应占每股盈利					
基本	0.022	0.005	0.012	340.0 %	83.3 %
摊薄	0.022	0.005	0.012	340.0 %	83.3 %
付运晶圆(折合 8 吋千片)	1,538	1,305	1,453	17.9 %	5.8 %
产能利用率 ¹	102.8 %	108.3 %	99.7%	(5.5)	3.1
净资产收益率 ²	2.4 %	0.4 %	1.2 %	2.0	1.2

二零二六年第二季度

- 销售收入创历史新高, 达 7.175 亿美元, 同比增长 26.8%, 环比增长 8.6%, 主要得益于付运晶圆数量上升及平均销售价格上涨。
- 毛利率16.5%, 同比上升 5.6 个百分点, 环比上升 3.5 个百分点, 主要得益于平均销售价格上涨及降本增效, 部分被折旧成本上升所抵消。
- 经营开支1.091 亿美元, 同比上升 11.4%, 环比上升 3.3%, 主要由于员工开支上升。
- 其他收入净额 220 万美元, 同比下降 79.4%, 主要由于财务费用上升及政府补贴下降, 部分被分占联营公司溢利上升所抵消; 上季度为其他损失净额 240 万美元, 主要由于占联营公司溢利上升。
- 所得税开支760 万美元, 同比上升 7.5%。
- 期内溢利/390 万美元, 上年同期为损失 3,280 万美元, 上季度为损失 1,730 万美元。
- 母公司拥有人应占利润3,860 万美元, 同比上升 385.9%, 环比上升 84.6%。
- 基本每股盈利 0.022 美元, 同比上升 340.0%, 环比上升 83.3%。
- 净资产收益率 (年化) 2.4%, 同比上升 2.0 个百分点, 环比上升 1.2 个百分点。

¹产能利用率按平均月约当产量除以总估计月产能计算。

²母公司拥有人应占利润 / 加权平均母公司拥有人应占净资产。

销售收入分析

按类别划分的 销售收入	二零二六年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二六年 第二季度 % (未经审核)	二零二五年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
晶圆	692,177	96.5 %	541,076	95.6 %	151,101	27.9 %
其他	25,360	3.5 %	24,989	4.4 %	371	1.5 %
销售收入总额	717,537	100.0 %	566,065	100.0 %	151,472	26.8 %

- 本季度 96.5%的销售收入来源于半导体晶圆的直接销售。

销售收入分析

按晶圆尺寸划分的 销售收入	二零二六年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二六年 第二季度 % (未经审核)	二零二五年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
8 吋晶圆	271,811	37.9 %	232,308	41.0 %	39,503	17.0 %
12 吋晶圆	445,726	62.1 %	333,757	59.0 %	111,969	33.5 %
销售收入总额	717,537	100.0 %	566,065	100.0 %	151,472	26.8 %

- 本季度来自于 8 吋晶圆和 12 吋晶圆的销售收入分别为 2.718 亿美元及 4.457 亿美元。

销售收入分析

按地域划分的 销售收入	二零二六年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二六年 第二季度 % (未经审核)	二零二五年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
中国 ³	563,704	78.6 %	469,674	83.0 %	94,030	20.0 %
北美 ⁴	93,842	13.1 %	53,007	9.4 %	40,835	77.0 %
亚洲其他 ⁵	31,983	4.4 %	28,647	5.0 %	3,336	11.6 %
欧洲	28,008	3.9 %	14,737	2.6 %	13,271	90.1 %
销售收入总额	717,537	100.0 %	566,065	100.0 %	151,472	26.8 %

- 本季度来自于中国的销售收入 5.637 亿美元，占销售收入总额的 78.6%，同比增长 20.0%，主要得益于 MCU、闪存、通用 MOSFET、逻辑及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度来自于北美的销售收入 9,380 万美元，同比增长 77.0%，主要得益于其他电源管理及 MCU 产品的需求增加。
- 本季度来自于亚洲其他地区的销售收入 3,200 万美元，同比增长 11.6%，主要得益于超级结及 MCU 产品的需求增加。
- 本季度来自于欧洲的销售收入 2,800 万美元，同比增长 90.1%，主要得益于 MCU 及智能卡芯片的需求增加。

³ 包括中国大陆及中国香港。

⁴ 包括于 2020 年由一家总部位于欧洲的公司所收购的一家主要美国客户。

⁵ 包括中国台湾及日本。

销售收入分析

按技术平台划分的 销售收入	二零二六年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二六年 第二季度 % (未经审核)	二零二五年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
嵌入式非易失性存储器	200,116	27.9 %	141,158	24.9 %	58,958	41.8 %
独立式非易失性存储器	68,803	9.6 %	27,603	4.9 %	41,200	149.3 %
功率器件	182,309	25.4 %	166,713	29.5 %	15,596	9.4 %
逻辑及射频	83,203	11.6 %	68,589	12.1 %	14,614	21.3 %
模拟与电源管理	183,106	25.5 %	162,002	28.6 %	21,104	13.0 %
销售收入总额	717,537	100.0 %	566,065	100.0 %	151,472	26.8 %

- 本季度嵌入式非易失性存储器销售收入 2.001 亿美元，同比增长 41.8%，主要得益于 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度独立式非易失性存储器销售收入 6,880 万美元，同比增长 149.3%，主要得益于闪存产品的需求增加。
- 本季度功率器件销售收入 1.823 亿美元，同比增长 9.4%，主要得益于通用 MOSFET 产品需求增加。
- 本季度逻辑及射频销售收入 8,320 万美元，同比增长 21.3%，主要得益于逻辑产品的需求增加。
- 本季度模拟与电源管理销售收入 1.831 亿美元，同比增长 13.0%，主要得益于其他电源管理产品的需求增加。

销售收入分析

按工艺技术节点划分的销售收入	二零二六年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二六年 第二季度 % (未经审核)	二零二五年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
65nm 及以下	205,069	28.6 %	125,537	22.2 %	79,532	63.4 %
90nm 及 95nm	174,350	24.3 %	145,447	25.7 %	28,903	19.9 %
0.11μm 及 0.13μm	78,183	10.9 %	64,011	11.3 %	14,172	22.1 %
0.15μm 及 0.18μm	38,182	5.3 %	29,059	5.1 %	9,123	31.4 %
0.25μm	2,104	0.3 %	1,174	0.2 %	930	79.2 %
0.35μm 及以上	219,649	30.6 %	200,837	35.5 %	18,812	9.4 %
销售收入总额	717,537	100.0 %	566,065	100.0 %	151,472	26.8 %

- 本季度 65nm 及以下工艺技术节点的销售收入 2.051 亿美元，同比增长 63.4%，主要得益于闪存及其他电源管理产品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工艺技术节点的销售收入 1.744 亿美元，同比增长 19.9%，主要得益于 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度 0.11μm 及 0.13μm 工艺技术节点的销售收入 7,820 万美元，同比增长 22.1%，主要得益于 MCU 产品的需求增加。
- 本季度 0.15μm 及 0.18μm 工艺技术节点的销售收入 3,820 万美元，同比增长 31.4%，主要得益于其他电源管理及 MCU 产品的需求增加。
- 本季度 0.25μm 工艺技术节点的销售收入 210 万美元，同比增长 79.2%，主要得益于 RF 产品的需求增加。
- 本季度 0.35μm 及以上工艺技术节点的销售收入 2.196 亿美元，同比增长 9.4%，主要得益于通用 MOSFET 产品的需求增加。

销售收入分析

按终端市场分布划分的销售收入	二零二六年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二六年 第二季度 % (未经审核)	二零二五年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
消费电子	481,266	67.1 %	357,370	63.1 %	123,896	34.7 %
工业及汽车	162,071	22.6 %	129,150	22.8 %	32,921	25.5 %
通信	62,493	8.7 %	71,638	12.7 %	(9,145)	(12.8)%
计算	11,707	1.6 %	7,907	1.4 %	3,800	48.1 %
销售收入总额	717,537	100.0 %	566,065	100.0 %	151,472	26.8 %

- 本季度消费电子作为我们的第一大终端市场，贡献销售收入 4.813 亿美元，占销售收入总额的 67.1%，同比增长 34.7%，主要得益于闪存、MCU、其他电源管理及通用 MOSFET 产品的需求增加。
- 本季度工业及汽车产品销售收入 1.621 亿美元，同比增长 25.5%，主要得益于其他电源管理、智能卡芯片及 MCU 产品的需求增加。
- 本季度通信类产品销售收入 6,250 万美元，同比下降 12.8%，主要由于模拟产品需求下降。
- 本季度计算类产品销售收入 1,170 万美元，同比增长 48.1%，主要得益于 MCU 产品的需求增加。

产能⁶及产能利用率

	二零二六年 第二季度 (未经审核)	二零二五年 第二季度 (未经审核)	二零二六年 第一季度 (未经审核)
总产能(折合 8 吋千片晶圆)	508	447	489
总体产能利用率	102.8%	108.3%	99.7%

- 本季度末月产能 508,000 片 8 吋等值晶圆。总体产能利用率为 102.8%。

付运晶圆

折合 8 吋千片晶圆	二零二六年 第二季度 (未经审核)	二零二五年 第二季度 (未经审核)	二零二六年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
付运晶圆	1,538	1,305	1,453	17.9 %	5.8 %

- 本季度付运晶圆 1,538,000 片，同比上升 17.9%，环比上升 5.8%。

⁶ 期末月产能，且为比较目的，以 30 天作为计算基础。

经营开支分析

以千美元计	二零二六年 第二季度 (未经审核)	二零二五年 第二季度 (未经审核)	二零二六年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
销售及分销费用	2,961	2,630	2,358	12.6 %	25.6 %
管理费用 ⁷	104,403	94,687	102,548	10.3 %	1.8 %
贸易应收款项及应收票据减值损失	1,719	600	707	186.5 %	143.1 %
经营开支	109,083	97,917	105,613	11.4 %	3.3 %

■ 经营开支1.091亿美元，同比上升11.4%，环比上升3.3%，主要由于员工开支上升。

其他收入/(损失)净额

以千美元计	二零二六年 第二季度 (未经审核)	二零二五年 第二季度 (未经审核)	二零二六年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
租金收入	3,927	3,460	3,229	13.5 %	21.6 %
利息收入	11,600	15,294	10,394	(24.2)%	11.6 %
汇兑收入/(损失)	504	(1,064)	5,105	(147.4)%	(90.1)%
分占联营公司溢利	9,491	591	153	1,505.9 %	6,103.3 %
财务费用	(29,423)	(18,250)	(27,681)	61.2 %	6.3 %
政府补贴	4,682	9,866	5,634	(52.5)%	(16.9)%
其他	1,408	705	718	99.7 %	96.1 %
其他收入/(损失)净额	2,189	10,602	(2,448)	(79.4)%	(189.4)%

■ 其他收入净额220万美元，同比下降79.4%，主要由于财务费用上升及政府补贴下降，部分被分占联营公司溢利上升所抵消；上季度为其他损失净额240万美元，主要由于占联营公司溢利上升。

⁷ 管理费用包括确认为研发开支抵减项目的政府补助。

现金使用分析

以千美元计	二零二六年 第二季度 (未经审核)	二零二五年 第二季度 (未经审核)	二零二六年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
经营活动所得现金流量净额	338,054	169,630	130,427	99.3 %	159.2 %
投资活动所用现金流量净额	(331,165)	(385,556)	(856,988)	(14.1)%	(61.4)%
融资活动所(用)/得现金流量净额	(405,961)	(25,185)	638,664	1,511.9 %	(163.6)%
外汇汇率变动影响净额	63,423	8,076	61,962	685.3 %	2.4 %
现金及现金等价物变动影响净额	(335,649)	(233,035)	(25,935)	44.0 %	1,194.2 %

- 本季度经营活动所得现金流量净额 3.381 亿美元，同比上升 99.3%，环比上升 159.2%，主要由于客户收款上升。
- 投资活动所用现金流量净额 3.312 亿美元，其中包括固定资产投资支出 3.566 亿美元，对外投资 1,610 万美元，部分被收到政府对设备的补贴 2,540 万美元，利息收入 860 万美元，收到联营公司分红 730 万美元及设备处置款 20 万美元所抵消。
- 融资活动所用现金流量净额 4.060 亿美元，其中偿还银行借款 5.690 亿美元，支付利息 3,760 万美元，支付租赁负债 100 万美元，部分被提取银行借款 2.015 亿美元，员工行权发行股份收到 10 万美元所抵消。

资本结构

以千美元计	于六月三十日 二零二六年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二六年 (未经审核)
资产总额	15,225,807	14,947,323
负债总额	5,528,378	5,662,963
所有者权益总额	9,697,429	9,284,360
资产负债率 ⁸	36.3%	37.9%

资本开支

以千美元计	二零二六年 第二季度 (未经审核)	二零二六年 第一季度 (未经审核)
华虹 8 吋	30,683	38,725
华虹 12 吋	325,883	886,146
合计	356,566	924,871

- 本季度资本开支 3.566 亿美元，其中 3.259 亿美元用于华虹 12 吋，3,070 万美元用于华虹 8 吋。

⁸ 资产负债率=负债总额/资产总额。

流动性分析

以千美元计	于六月三十日 二零二六年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二六年 (未经审核)
已竣工待售物业	222,405	218,918
存货	584,782	533,311
贸易应收款项及应收票据	322,463	313,053
预付款项、其他应收款项及其他资产	701,266	661,570
应收关联方款项	12,552	14,153
已冻结及定期存款	45,355	44,646
现金及现金等价物	4,532,224	4,867,873
流动资产总额	6,421,047	6,653,524
贸易应付款项	289,753	270,387
其他应付款项及暂估费用	829,746	735,491
计息银行借款	1,902,063	811,820
一年内到期长期应付款	7,331	-
租赁负债	2,006	4,652
政府补助	115,740	90,371
应付关联方款项	12,913	4,996
应付所得税	14,549	17,912
流动负债总额	3,174,101	1,935,629
净营运资金	3,246,946	4,717,895
速动比率	1.8x	3.0x
流动比率	2.0x	3.4x
贸易应收款项及应收票据周转天数	40	41
存货周转天数	84	84

- 存货由上季度末的 5.333 亿美元上升至本季度末的 5.848 亿美元，主要由于在制品增加。
- 预付款项、其他应收款项及其他资产由上季度末的 6.616 亿美元上升至本季度末的 7.013 亿美元，主要由于增值税留抵税额增加。
- 其他应付款项及暂估费用由上季度末的 7.355 亿美元上升至本季度末的 8.297 亿美元，主要由于应付资本支出增加。
- 计息银行借款由上季度末的 8.118 亿美元上升至本季度末的 19.026 亿美元，主要由于长期借款的一年内到期部分增加。
- 政府补助由上季度末的 9,040 万美元上升至本季度末的 1.157 亿美元，主要由于本季度收到政府补助款项。
- 净营运资金本季度末 32.469 亿美元，流动比率 2.0。
- 贸易应收款项及应收票据周转天数 40 天。
- 存货周转天数 84 天。

上述公布详情请参阅华虹宏力半导体网站 www.huahonggrace.com。

华虹宏力半导体有限公司
简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三个月		
	于六月三十日	于六月三十日	于三月三十一日
	二零二六年 (未经审核)	二零二五年 (未经审核)	二零二六年 (未经审核)
销售收入	717,537	566,065	660,925
销售成本	(599,133)	(504,454)	(574,866)
毛利	118,404	61,611	86,059
其他收入及收益	22,121	29,353	25,100
销售及分销费用	(2,961)	(2,630)	(2,358)
管理费用	(104,403)	(94,687)	(102,548)
贸易应收款项及应收票据减值损失	(1,719)	(600)	(707)
其他费用	-	(1,092)	(20)
财务费用	(29,423)	(18,250)	(27,681)
分占联营公司溢利	9,491	591	153
税前溢利/(损失)	11,510	(25,704)	(22,002)
所得税(开支)/抵免	(7,632)	(7,097)	4,735
期内溢利/(损失)	3,878	(32,801)	(17,267)
以下各方应占：			
母公司拥有人	38,639	7,952	20,929
非控股权益	(34,761)	(40,753)	(38,196)
持有人应占每股盈利			
基本	0.022	0.005	0.012
摊薄	0.022	0.005	0.012
用于计算持有人应占每股基本盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,737,663,520	1,726,241,791	1,737,629,193
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,737,721,373	1,731,895,843	1,737,760,230

华虹宏力半导体有限公司
简明综合财务状况表(以千美元计)

	截至		
	于六月三十日 二零二六年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二六年 (未经审核)	于六月三十日 二零二五年 (未经审核)
资产			
非流动资产			
物业、厂房及设备	7,286,266	7,105,886	6,101,971
投资物业	226,803	223,247	218,468
使用权资产	57,262	64,125	66,002
无形资产	30,483	32,834	27,313
于联营公司的投资	183,072	152,751	144,421
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具	787,420	486,369	290,515
以公允价值计量且变动计入损益的金融资产	8,809	-	-
长期预付款项	224,645	228,587	42,672
递延所得税资产	-	-	765
非流动资产总额	8,804,760	8,293,799	6,892,127
流动资产			
已竣工待售物业	222,405	218,918	221,661
存货	584,782	533,311	513,434
贸易应收款项及应收票据	322,463	313,053	264,329
预付款项、其他应收款项及其他资产	701,266	661,570	452,513
应收关联方款项	12,552	14,153	14,360
已冻结存款及定期存款	45,355	44,646	31,756
现金及现金等价物	4,532,224	4,867,873	3,846,900
流动资产总额	6,421,047	6,653,524	5,344,953
流动负债			
贸易应付款项	289,753	270,387	263,352
其他应付款项及暂估费用	829,746	735,491	716,648
计息银行借款	1,902,063	811,820	341,313
一年内到期长期应付款	7,331	-	-
租赁负债	2,006	4,652	5,839
政府补助	115,740	90,371	59,040
应付关联方款项	12,913	4,996	8,560
应付所得税	14,549	17,912	16,046
流动负债总额	3,174,101	1,935,629	1,410,798
流动资产净额	3,246,946	4,717,895	3,934,155
总资产减流动负债	12,051,706	13,011,694	10,826,282
非流动负债			
计息银行借款	1,665,485	3,085,413	1,933,971
租赁负债	7,938	13,476	15,035
递延税项负债	67,251	24,463	3,633
长期应付款	613,603	603,982	-
非流动负债总额	2,354,277	3,727,334	1,952,639
净资产	9,697,429	9,284,360	8,873,643
权益和负债权益			
股本	4,987,827	4,987,537	4,960,855
储备	2,150,209	1,743,223	1,339,047
本公司拥有人应占权益	7,138,036	6,730,760	6,299,902
非控股权益	2,559,393	2,553,600	2,573,741
权益总额	9,697,429	9,284,360	8,873,643

华虹宏力半导体有限公司
简明综合现金流量表(以千美元计)

	截至以下日期止三个月		
	于六月三十日	于六月三十日	于三月三十一日
	二零二六年 (未经审核)	二零二五年 (未经审核)	二零二六年 (未经审核)
经营活动现金流量：			
税前溢利/(亏损)	11,510	(25,704)	(22,002)
折旧及摊销	233,468	179,658	214,606
应占联营公司溢利	(9,491)	(591)	(153)
营运资金的变动及其它	102,567	16,267	(62,024)
经营活动所得现金流量净额	338,054	169,630	130,427
投资活动现金流量：			
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(356,566)	(407,728)	(924,871)
投资其他权益工具	(7,286)	-	-
投资以公允价值计量且变动计入损益的金融资产	(8,809)	-	-
投资联营企业	-	(2,794)	-
收到政府对设备的补助	25,394	-	-
定期存款的减少	-	-	57,794
收到联营公司分配股息	7,286	-	-
其他投资活动所得现金流量	8,816	24,966	10,089
投资活动所用现金流量净额	(331,165)	(385,556)	(856,988)
融资活动现金流量：			
提取银行贷款	201,506	138,096	649,364
发行股份所得收益	106	2,218	3,343
偿还银行贷款	(568,985)	(125,677)	(828)
已付利息	(37,605)	(38,623)	(12,137)
支付租赁负债	(983)	(1,199)	(1,078)
融资活动所用/(得)现金流量净额	(405,961)	(25,185)	638,664
现金及现金等价物减少净额	(399,072)	(241,111)	(87,897)
期初现金及现金等价物	4,867,873	4,079,935	4,893,808
外汇汇率变动影响净额	63,423	8,076	61,962
期末现金及现金等价物	4,532,224	3,846,900	4,867,873

于本公告日期，本公司董事分别为：

执行董事

白鹏(董事长兼总裁)

非执行董事

叶峻

孙国栋

陈博

熊承艳

独立非执行董事

张祖同

王桂壖太平绅士

封松林

承董事会命

华虹宏力半导体有限公司

白鹏

董事长兼执行董事

中国 香港

二零二六年八月十三日